

# 第25回 2015ワークショップ 開催案内

## 日本ブランド復権のカギを握る実装イノベーション

～ 日本ならではの、の技術で実現する魅力的機能・品質！～

2015年10月15日(木)～16日(金)

ラフォーレ修善寺 研修センター にて開催



エレクトロニクス実装学会では、実装技術に関するワークショップを、10月15日(木)～16日(金)の2日間、ラフォーレ修善寺(静岡県伊豆市) 研修センターにて開催いたします。

『日本ブランド復権のカギを握る実装イノベーション ～日本ならではの、の技術で実現する魅力的機能・品質！～』というテーマを掲げ、以下のような魅力的なプログラムを予定しております。

1. **招待講演** : 貫井 孝 様 (大阪大学 産業科学研究所 招聘教授)  
『エレクトロニクス製造業の再興に向けて ～バリューチェーンの現状、課題、そしてその克服への道を探る～』
2. **48件の一般ポスター発表**
3. **25周年 特別企画** : 上田 弘孝 様 (セミコンサルト) による『携帯～ウェアラブルの分解展示』と『電子機器分解品から読み解く最新実装技術』(ナイトセッション講演) /25周年ポスター

このワークショップでは、通常の講演会や学会とは異なり、ポスターの前で発表者と参加者が一体となり、双方向のディスカッションを中心に行います。2日間にわたる熱い議論の中から、課題解決へのヒントや将来の夢、新たな問題提起や異分野の方々とのネットワーク構築等々、多くの成果を必ずやお持ち帰りいただけるものと確信しております。詳細情報は、学会ホームページ (<http://www.e-jisso.jp/>) を参照してください。

2015ワークショップ実行委員会 委員長 坪井 一彦 (コニカミルタ)

### 費用・申込方法

申し込み: **当学会ホームページ(<http://www.e-jisso.jp/>)掲載の「2015ワークショップ」→「参加申込はこちら」からお申し込みください。**

参加費用: 正会員・賛助会員: ¥45,000、一般: ¥55,000、学生: ¥35,000

(宿泊費、食事、消費税を含みます。\*なお一般の方は、同時に学会にご入会いただくと、初年度のみ年会費半額で、かつ今回のワークショップに**会員扱い**でご参加いただけます。)

申込締切: 10月5日(月) (ただし、定員になり次第、締め切らせていただきます。)

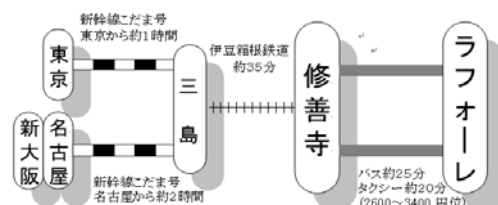
定員: 100名(先着申込順)

支払方法: 請求書到着後、銀行振込にて。お申込み後のキャンセルはできません。

申込先: (一社) エレクトロニクス実装学会 ワークショップ(修善寺)係

問合せ先: 〒167-0042 東京都杉並区西荻窪北 3-12-2, Tel:03-5310-2010,  
Email: workshop@jiep.or.jp

### アクセス



### スケジュール

10月15日(木)		10月16日(金)	
13:00～	登録開始	07:30～08:30	朝食
13:30～14:00	オリエンテーション	09:00～	2日目セッション開始
14:00～15:00	第1セッション(アブストラクトトーク)	09:30～10:30	第3セッション(アブストラクトトーク)
15:00～17:40	第1セッション(ポスター)	10:30～11:50	第3セッション(ポスター前半)
18:30～20:30	夕食(立食形式懇親会)	11:50～12:30	昼食
21:00～22:00	ナイトセッション(25周年特別企画の一環)	12:30～13:50	第3セッション(ポスター後半)
22:00～	第2セッション(自由討論)	13:55～14:55	招待講演
	就寝	15:00～	アンケート・閉会式・現地解散

### プログラム



裏面へ!

招待講演 : 『エレクトロニクス製造業の再興に向けて』

貫井 孝 / 大阪大学

ナイトセッション : 『電子機器分解品から読み解く最新実装技術』

上田 弘孝 / セミコンサルト

	10月15日(木)	10月16日(金)
実装関連材料	1. 外部応力型ウイスカ抑制はんだ合金の検討 岩本 博之 / 千住金属工業	25. 高周波基板の可能性を広げる圧延銅箔 福地 亮 / JX日鉱日石金属
	2. 空気下硬化可能な導電性銅ペーストの開発 梶田 昌志 / ナミックス	26. 高性能絶縁接着フィルム 高橋 聡子 / ナミックス
	3. 高品質エピタキシャルダイヤモンド基板 澤邊 厚仁 / 青山学院大学	27. 高感度・高解像度な新規重合開始剤の開発 田町 知也 / ADEKA
	4. 低熱膨張樹脂を旨とした樹脂の収縮メカニズムの検討 安部 慎一郎 / 日立化成	28. 様々なプロセスに対応する新規なエポキシ化合物 大森 健太郎 / 日産化学工業
	5. 半導体実装のための無機異方性導電材料の開発 山下 広祐 / 富士フィルム	29. Pbフリークリームはんだ用エポキシ系フラックスによる回路基板の高接合信頼性化と無洗浄化 雁部 竜也 / 富士電機
	6. 半導体パッケージ向け先端めっき用フォトレジストの開発 松本 朋之 / JSR	30. 金属微細配線形成に適したリフトオフレジスト 伊東 宏和 / JSR
	7. 電着フォトレジスト“ハニレジスト” 丸田 博之 / ハニー化成	31. 次世代パッケージ用感光性材料 福原 紀一 / 日立化成
プロセス/装置	8. スマート社会に向けた実装装置 河原 幹之 / TDK	32. 省エネルギー炉の開発 永井 耕一 / パナソニック
	9. 真空およびプラズマを利用した実装装置の紹介 : パワー素子実装、フラックスレス・ポイドフリー実装 萩原 泰三 / 神港精機	33. 耐熱絶縁性に優れた金属材料用表面処理剤の開発 大浦 一郎 / 日本パーカライジング
	10. モジュール型汎用自動組立装置SmartFABによる3D-MID実装の現状と課題 濱根 剛 / 富士機械製造	34. 高温はんだ実装を可能にする金錫合金めっき 三浦 光司 / ミツ矢
	11. 銀ナワイヤを用いた透明電極技術 山木 繁 / 昭和電工	35. 【傷の気付き】処理の展開 - 傷のみに気付き処理の検討 - 青木 公也 / 中京大学
	12. 高いスクリーン印刷性能を有する高導電性銅ペーストの開発 田上 安宣 / 日油	36. 積層ずれによる特性劣化を低減可能なチップ部品実装部の検討 小松 聖児 / 三菱電機
	13. SiCパワーデバイス向け接合技術の開発 佐藤 弘 / 産業技術総合研究所	37. NCFを用いたファインピッチ対応低コストCuピラー・フリップ・チップ・ボンディング工法の開発 坂田 賢治 / ルネサスエレクトロニクス
先端PKG/信頼性	14. 空隙を有するフェライトコアの低ノイズ実装方法に関する検討 福増 圭輔 / 日立製作所	38. 熱輸送特性を反映したヒートパイプ付きヒートシンクの熱解析技術 山口 翔 / 東芝
	15. 高加速温湿度評価の現状と課題 津久井 勤 / リサーチラボ・ツクイ	39. パーチャルの世界を実現できる唯一の実験装置 = T3Ster 今田 理子 / メンター・グラフィックス・ジャパン
	16. 低熱膨張有機基板の反り挙動解析と反り対策に関する考察 小原 さゆり / 日本IBM	40. 3次元デジタル画像関連法による発光ダイオードの変形計測 田口 秀幸 / コベルコ科研
	17. 3次元積層ICを用いたパッケージ熱応力設計 村上 嘉浩 / テンソー	41. はんだフラックス由来の臭素が関与したウイスカ状突起物の発生 斎藤 彰 / 村田製作所
	18. 有機基板に対するガラス配線基板の接続信頼性に及ぼす基板のCTE差の影響 土田 徹勇起 / 凸版印刷	42. フレキシブルデバイスの実装を志向した、フィルム型接続技術の繰り返し曲げ試験における電気特性 三井 亮介 / 日本航空電子工業
	19. 3次元パッケージソリューション開発の取組み 岩崎 俊寛 / ジェイデバイス	43. 革新的半導体パッケージ組立技術 - PLP (Panel Level Package) 技術の特徴とパフォーマンス - 稲岡 俊幸 / ジェイデバイス
	20. 高密度ガラス/シリコン/有機インターポーザの開発 高野 昭仁 / 新光電気工業	44. 超広帯域・超低電源インピーダンスを実現する狭間隔実装技術によるキャパシタ内蔵有機インターポーザ 菊地 克弥 / 産業技術総合研究所
光・高速/アプリ	21. 5mm角の超高速・超低消費電力チップ・サイズ・光トランシーバ「光I/Oコア」 竹村 浩一 / 光電子融合基盤技術研究所	45. 車載遠隔操作デバイス 畑中 真二 / テンソー
	22. Ultrathin and Ultraflexible Electronics for Wearable Application and Its Beyond 網盛 一郎 / 東京大学	46. 高周波信号伝送のコペルニクスの転回 - GHz信号伝送の基本原則 橋本 薫 / 明星大学
	23. イメージセンサのチップサイズパッケージに関する研究と医療デバイスへの応用 巢山 拓郎 / オリンパス	47. ワイヤレス給電技術と回路技術 篠原 真毅 / 京都大学
	24. 車載パワーエレクトロニクス実装に向けたプリント配線板技術 戸田 光昭 / メイコー	48. シリコンフォトリソプラットフォーム用光電ハイブリッド集積チップ実装技術 碓氷 光男 / 日本電信電話
		49. 有版印刷での最新技術紹介と実装技術への応用の可能性 坂本 剛 / コムテック